

電子回路基板製造において使用する可能性があるPRTR対象物質一覧

改正施行令対象物質				用途			製品に含有される	製品に残存しない
種	号番号	特定第1種	物質名称	CAS番号(参考)	工程	使用資機材		
1	9		アクリロニトリル	107-13-1	ソルダレジスト	ドライフィルム		○
1	12		アセトアルデヒド	75-07-0	現像処理	現像液		○
1	20		2-アミノエタノール	141-43-5	現像処理	現像液中和剤		○
1	20		2-アミノエタノール	141-43-5	無電解銅めっき	脱脂液		○
1	20		2-アミノエタノール	141-43-5	はんだ付け	ポストフラックス	一部製品のみ	○
1	22		5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール(別名フィプロニル)	120068-37-3	銅めっき	銅めっき液		○
1	31		アンチモン及びその化合物	-	ソルダレジスト	シンボルマーク印刷用インク(黄色)		○
1	31		アンチモン及びその化合物	-	銅張積層板製造工程(FPC)	接着剤添加剤(難燃剤)	一部製品のみ	○
1	31		アンチモン及びその化合物	-	銅張積層板製造工程	紙フェノール基材(難燃剤)		○
1	31		アンチモン及びその化合物	-	はんだ付け	クリームはんだ	一部製品のみ	○
1	44		インジウム及びその化合物	-	はんだ付け	クリームはんだ	一部製品のみ	○
1	44		インジウム及びその化合物	-	銅張積層板製造工程	銅箔(表面処理剤)	一部製品のみ	○
1	53		エチルベンゼン	100-41-4	ソルダレジスト	フォトソルダレジスト(シンナー)		○
1	57		エチレングリコールモノエチルエーテル	110-80-5	フラックス膜剥離	フラックス膜剥離液		○
1	58		エチレングリコールモノメチルエーテル	109-86-4	印刷	印刷インク溶剤		○
1	59		エチレンジアミン	107-15-3	銅めっき	銅めっき液		○
1	60		エチレンジアミン四酢酸	60-00-4	無電解銅めっき	無電解銅めっき液添加剤		○
1	71		塩化第二鉄	7705-08-0	エッチング	エッチング液		○
1	71		塩化第二鉄	7705-08-0	はんだ剥離	はんだ剥離液		○
1	71		塩化第二鉄	7705-08-0	排水処理(凝縮沈殿で行う場合)		※汚泥・廃液の中に塩化第二鉄が含まれるか要確認	○
1	80		キシレン	1330-20-7	洗浄	溶剤		○
1	80		キシレン	1330-20-7	マスクパターン	銀塩フィルム		○
1	80		キシレン	1330-20-7	印刷	インク、シンナー成分		○
1	80		キシレン	1330-20-7	フラックス	フラックス溶剤		○
1	82		銀及びその水溶性化合物	-	表面処理	鉛フリーはんだ	*一部製品のみ	○
1	82		銀及びその水溶性化合物	-	銀穴埋め	銀ペースト		○
1	82		銀及びその水溶性化合物	-	印刷	銀ペースト		○
1	82		銀及びその水溶性化合物	-	はんだ付け	クリームはんだ	一部製品のみ	○
1	84		グリオキサール	107-22-2	めっき	めっき液添加剤		○
1	87		クロム及び三価クロム化合物	-	銅張積層板製造工程	銅箔(表面処理剤)	一部製品のみ	○
1	132		コバルト及びその化合物	-	金めっき	硬質金めっき		○
1	132		コバルト及びその化合物	-	銅箔製造工程	銅箔(特性向上)		○
1	133		酢酸2-エトキシエチル(別名エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート)	111-15-9	ソルダレジスト	液状レジストインク		○
1	133		酢酸2-エトキシエチル(別名エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート)	111-15-9	文字印刷	文字インク	1部のみ	○
1	144		無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	-	表面粗化	めっき前処理		○
1	144		無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	-	金めっき	シアン化金カリウム		○
1	144		無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	-	無電解銅めっき	シアン化ナトリウム		○

改正施行令対象物質				用途			製品に含有される	製品に残存しない
種	号番号	特定第1種	物質名称	CAS番号(参考)	工程	使用資機材		
1	145		2-(ジエチルアミノ)エタノール	100-37-8	洗浄	溶剤		○
1	150		1,4-ジオキサン	123-91-1	接着剤	溶剤	極微量残渣として製品に含有する可能性あり	○
1	154		シクロヘキシルアミン	108-91-8	フラットエッチング	ソフトエッチング液		○
1	180		3,3'-ジクロロベンジジン	91-94-1	印刷	フィルムクリーナー		○
1	185		ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC-225)	-	洗浄	洗浄剤		○
1	232		N,N-ジメチルホルムアミド	68-12-2	銅めっき	銅めっき液		○
1	272		銅水溶性塩(錯塩を除く。)	-	銅めっき	硫酸銅		○
1	272			-	エッチング	エッチング液	※塩化第二鉄と銅の結合により生成される	○
1	277		トリエチルアミン	121-44-9	はんだ付け	ポストフラックス	一部製品のみ	○
1	278		トリエチレンテトラミン	112-24-4	はんだ付け	ポストフラックス	一部製品のみ	○
1	291		1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン	2451-62-9	ソルダレジスト	レジストインク硬化剤		○
1	295		3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノール	3452-97-9	表面処理	樹脂系プリフラックス希釈剤		○
1	297		1,3,5-トリメチルベンゼン	108-67-8	ソルダレジスト	希釈剤	一部製品のみ	○
1	300		トルエン	108-88-3	接着剤	溶剤		○
1	300				表面処理	耐熱性プリフラックス		○
1	300				ソルダレジスト	版洗浄クリーナー		○
1	302		ナフタレン	91-20-3	ソルダレジスト、シンボル印刷	インク	原料中に含有(揮発成分):一部製品のみ	○
1	304		鉛	7439-92-1	表面処理	はんだレベラー	*鉛フリーはんだは除く	○
1	304				無電解ニッケルめっき	無電解ニッケルめっき液	安定剤(0.1wt%未満)	○
1	304				表面処理	はんだ	*鉛フリーはんだは除く	○
1	304				はんだめっき	はんだ電極	*鉛フリーはんだは除く	○
1	304				はんだ付け	クリームはんだ	*鉛フリーはんだは除く	○
1	305	○	鉛化合物	-	表面処理	はんだレベラー	*鉛フリーはんだは除く	○
1	305				無電解ニッケルめっき	無電解ニッケルめっき液	安定剤(0.1wt%未満)	○
1	305				表面処理	はんだ	*鉛フリーはんだは除く	○
1	305				はんだめっき	はんだ電極	*鉛フリーはんだは除く	○
1	306		二アクリル酸ヘキサメチレン	13048-33-4	ソルダレジスト	ソルダレジストインキ	一部製品のみ	○
1	308		ニッケル	7440-02-0	ニッケルめっき	ニッケルめっき液		○
1	308				印刷	銀ペースト		○
1	309	○	ニッケル化合物	-	ニッケルめっき	ニッケルめっき液		○
1	309				文字印刷	シンボルマーク印刷用インク(黄色)		○
1	332	○	砒素及びその無機化合物	-	銅箔製造工程	銅箔(表面粗化)	*一部製品のみ	○
1	333		ヒドラジン	302-01-2	印刷	剥離促進剤		○
1	336		ヒドロキノン	123-31-9	現像処理	フィルム現像液		○
1	349		フェノール	108-95-2	銅張積層板製造工程(FPC)	接着剤主成分中の不純物	銅箔とカバーフィルムの接着剤*一部製品のみ	○
1	349				印刷	カーボンインク		○
1	349				銅張積層板製造工程	基材(紙フェノール)		○

改正施行令対象物質				用途			製品に 含有される	製品に 残存しな い	
種	号番号	特定 第1種	物質名称	CAS番号 (参考)	工程	使用資機材			備考
1	355		フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	117-81-7	印刷	ストリップブルマスク	一部メーカーの製品に含有 可塑剤として10%程度 セットメーカーで廃棄	○	
1	374		ふっ化水素及びその水溶性塩	-	銅めっき はんだホウフッ化浴 化学銅めっき	銅めっき液 ホウフッ化水素酸 アクセレータ/めっき液			○ ○ ○
1	392		ノルマル-ヘキサン	110-54-3	シルク	洗浄剤	RT-85(シンナー)		○
1	394	○	ベリリウム及びその化合物	-	ソルダレジスト	ソルダレジストインキ	一部製品のみ		○
1	395		ペルオキシニ硫酸の水溶性塩	-	表面粗化	めっき前処理			○
1	405		ほう素化合物	-	銅張積層板製造工程(FPC)	接着剤の添加剤	カバーフィルム用接着剤の難 燃剤用触媒 *一部製品のみ	○	
1	408		ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニル エーテル	9036-19-6	はんだ付け	ポストフラックス	一部製品のみ		○
1	411	○	ホルムアルデヒド	50-00-0	銅張積層板製造工程 無電解銅めっき	紙フェノール基材 無電解銅めっき液		○	○
1	411	○	ホルムアルデヒド	50-00-0	印刷	カーボンインク	一部製品のみ		○
1	412		マンガン及びその化合物	-	銅めっき デスマア	銅めっき液 デスマア液			○ ○
1	438		メチルナフタレン	1321-94-4	燃料		一部のA重油に含有		○
1	446		4, 4'-メチレンジアニリン	101-77-9	プリプレグ製造工程	プリプレグ	特殊な一部のメーカー・製品 のみ		○
1	453		モリブデン及びその化合物	-	銅張積層板製造工程	銅箔(表面処理剤)	一部製品のみ	○	